

**NORME
INTERNATIONALE
INTERNATIONAL
STANDARD**

**CEI
IEC
603-1
QC 010000**

1991-06

AMENDEMENT 1
AMENDMENT 1

1992-06

**Amendement 1
Connecteurs pour fréquences inférieures
à 3 MHz pour utilisation avec cartes imprimées**

Partie 1:
Spécification générique –
Prescriptions générales et guide de rédaction
des spécifications particulières,
avec assurance de la qualité

**Amendment 1
Connectors for frequencies below 3 MHz
for use with printed boards**

Part 1:
Generic specification –
General requirements and guide for
the preparation of detail specifications,
with assessed quality

© CEI 1992 Droits de reproduction réservés — Copyright — all rights reserved

Bureau central de la Commission Electrotechnique Internationale 3, rue de Varembe Genève Suisse



Commission Electrotechnique Internationale
International Electrotechnical Commission
Международная Электротехническая Комиссия

CODE PRIX
PRICE CODE

C

● Pour prix, voir catalogue en vigueur
For price, see current catalogue

AVANT-PROPOS

Cet amendement a été établi par le Sous-Comité 48B: Connecteurs, du Comité d'Etudes n° 48 de la CEI: Composants électromécaniques pour équipements électroniques.

Le texte de cet amendement est issu des documents suivants:

DIS	Rapport de vote
48B(BC)198	48B(BC)202

Le rapport de vote indiqué dans le tableau ci-dessus donne toute information sur le vote ayant abouti à l'approbation de cet amendement.

Page 2

SOMMAIRE

Ajouter ce qui suit après le titre de l'annexe A, page 4:

Annexe B – Longueurs recommandées des sorties à souder des connecteurs pour cartes imprimées.

FOREWORD

This amendment has been prepared by Sub-Committee 48B: Connectors, of IEC Technical Committee No. 48: Electromechanical Components for Electronic Equipment.

The text of this amendment is based on the following documents:

DIS	Report on Voting
48B(CO)198	48B(CO)202

Full information on the voting for the approval of this amendment can be found in the Voting Report indicated in the above table.

Page 3

CONTENTS

Add the following after the title of appendix A page 5:

Appendix B – Recommended termination lengths for printed board connectors having terminals intended to be flow soldered.

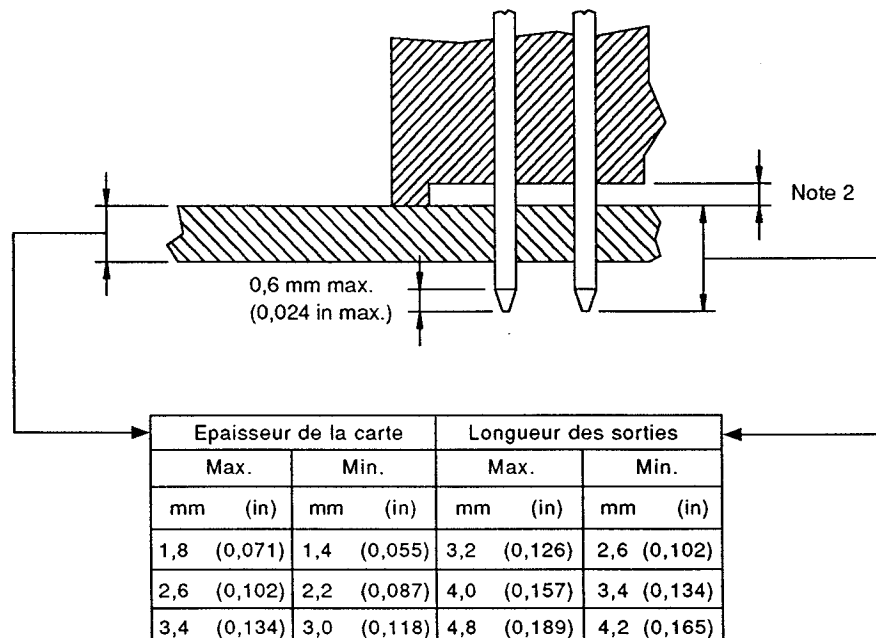
Ajouter la nouvelle annexe B suivante:

Annexe B

Longueurs recommandées des sorties à souder des connecteurs pour cartes imprimées

B.1 Généralités

Il est recommandé que les longueurs des sorties, indiquées dans les futures spécifications de connecteurs pour cartes imprimées, soient conformes aux valeurs suivantes.



NOTES

1 Les dimensions indiquées ne tiennent pas compte de la flèche tolérée pour la carte imprimée ou du moulage du connecteur.

2 La distance minimale entre la face supérieure de la carte imprimée et la partie inférieure du moulage du connecteur, ne doit pas être inférieure à 0,25 mm (0,010 in).

Cette distance est essentielle pour éviter les pièges d'humidité éventuelle, pour permettre l'évacuation des fumées pendant l'opération de soudage et aussi pour éliminer les restes de flux pendant le nettoyage, après l'opération de soudage.

La distance réelle nécessaire dépendra de la surface plane du connecteur et de la forme précise de la surface inférieure du moulage du connecteur. En général, plus la surface plane est grande, plus la distance nécessaire doit être grande.

Figure B.1

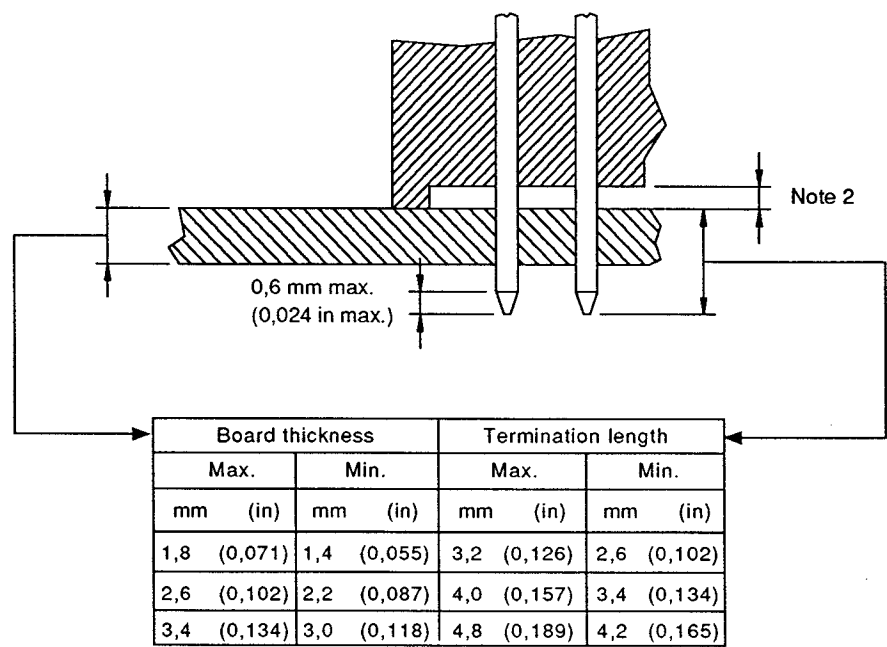
Add the following new appendix B:

Appendix B

Recommended termination lengths for printed board connectors having terminals intended to be flow soldered

B.1 General

It is recommended that future specifications for printed board connectors are aligned with the following details for termination lengths.



NOTES

1 The dimensions stated do not take into consideration any permissible bow of the printed board or the connector moulding.

2 The minimum clearance between the upper surface of the printed board and the lower surface of the connector moulding shall not be less than 0,25 mm (0,010 in).

Clearance is essential to avoid potential humidity traps, to allow the egress of fumes during solder processing and also to allow flux residue removal during cleaning after solder processing.

The actual clearance necessary will be a function of the connector plan area and the detail design of the lower surface of the connector moulding. In general, the larger the plan area, the larger the clearance required.

Figure B.1

ICS 33.220.10
